molex®

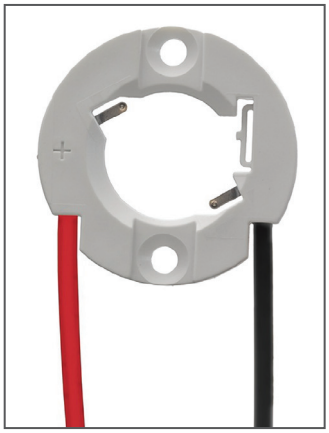
SlimRay™预接线式LED芯片基板（COB）阵列光源灯座

180555 13.35x13.3毫米LED芯片基板阵列光源灯座

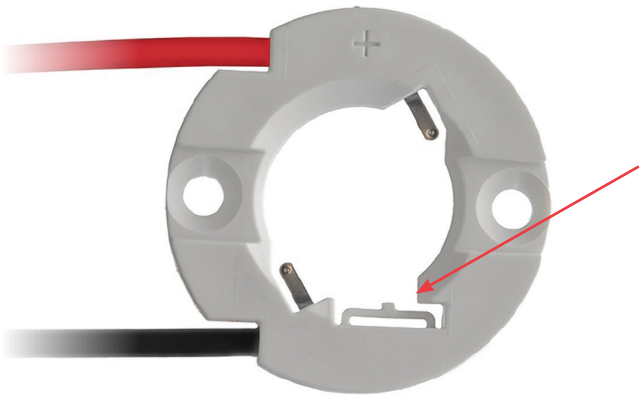
薄型预接线式SlimRay™ LED芯片基板阵列光源灯座采用压接触点进行连接，省去了手工焊接操作，因此简化了LED安装过程，缩短了装配时间。

特性和优点

灯座预装有端头剥去外皮的、以颜色区分极性的电源线，省去了手工焊接操作	能够直观识别阳极和阴极。减小了LED平面灯阵的损坏风险。专为配合Cree CXA13阵列而设计*
业界领先的薄型设计（3.15毫米厚度，可配合20 AWG导线的厚度）	可把光学器件靠近发光面安装。
电线的端接采用成熟的Molex压线工艺。	提供高耐久性和可靠性，有利于延长LED寿命。
引线通过插入注塑工艺与灯座形成一体，抓握灯座的力量大于50牛	引线对灯座的抓握力超强。确保LED阵列光源有稳定的接触界面。
一体化预固定凸片	在把组件安装到散热器上之前，用来固定阵列灯。若能在总装前把LED阵列光源固定在灯座上，则可最大限度缩短安装时间。
外壳设计坚固	即使在高温环境下也能确保长期稳定的机械连接。
与LED阵列灯相连接的压接触点采用镀金表面	在多种环境和条件下能稳定连接电源
提供连接反光罩的标准公制螺口附件	通过简单的对准和拧紧操作即可连接反光罩。



SlimRay™预接线式13.35 x 13.35毫米板载LED阵列光源灯座



在把组件安装到散热器上之前，用一体化预固定凸片来固定阵列灯。

*Cree是Cree公司的注册商标。

SlimRay™预接线式LED芯片基板（COB）阵列光源灯座

应用场合

各种通用照明场合
- 射灯
- 轨道灯
- 吊坠灯
- 线形灯

区域照明
- 道路
- 停车场
- 壁灯

住宅及商业楼宇中嵌入式射灯

产品规格

参考信息
包装：纸盒包装
UL档案编号：待定
UL认证待批 - 180555
CSA档案编号：
E345583 - 待批：180555
设计计量单位：毫米
是否符合RoHS标准：是
REACH SVHC：是否含有SVHC：否

电气参数
电压（最大值）：600伏直流
电流（最大值）：3.0安峰值电流
接触电阻：20毫欧最大变化量
介质耐电压：300伏直流
绝缘电阻（最小值）：5000兆欧

机械参数
引线拔脱力（最小值）：50牛
连接次数（最小值）：5次

物理参数
塑壳：白色PBT塑料，填充有30 玻纤，符合UL94V0防护等级
接脚材质：铜合金
电镀：
接点部位：镀金
底层电镀：镀镍

订购信息

订购号	板载灯阵尺寸	引线颜色	引线长度	一体化预固定凸片	安装方法	线槽	光器件附接位置
180555-0001	13.35x13.35毫米	黄、白	110.00毫米（±5毫米）	是	M2.5螺丝	无	平顶
180555-0002	13.35x13.35毫米	红、黑	254.00毫米（±5毫米）	是	M2.5螺丝	无	平顶

www.molex.com/link/cob.html
www.chinese.molex.com/link/cob.html
www.molex.com/industry/solidstatelighting.html
www.chinese.molex.com/industry/solidstatelighting.html

©2014 Molex